U 555 C



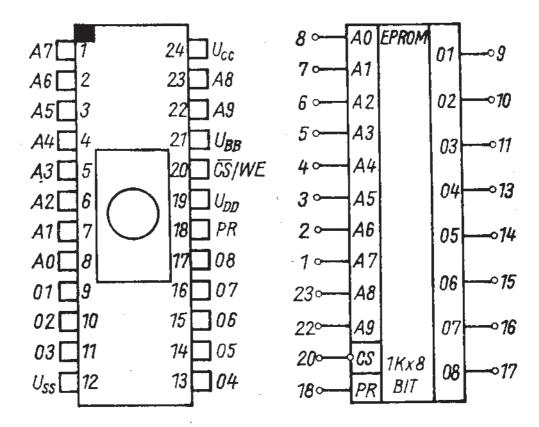
- Organisation 1 k \times 8 bit, TTL-kompatibel

- für CS = L ist der Festwertspeicher ausgewählt

- alle Eingänge sind mit integrierten Gateschutzelementen versehen

 der U 555 C ist mit entsprechendem Bitmuster dem ROM U 505 D anschluß- und bedingt signalkompatibel

Bauform 12



Strahlungsdosis für Löschung:

$$\sigma_{\rm w \ min} \ge 15 \ \frac{{\rm W_s}}{{\rm cm}^2} \ {\rm für \ Quarzglasdeckel}$$

$$\sigma_{\rm w \; min} \geq$$
 30 $\frac{\rm W_s}{\rm cm^2}$ für Keramikdeckel, $\lambda_{\rm UV} =$ 254 nm

Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 bis 8	Adresseneingänge	19	Betriebsspannung U _{DD}
9 bis 11	Datenein- und -ausgänge	20	Chip-Auswahl/Schreib-
12	Betrlebsspannung $U_{SS} =$		signal
•	Bezugspotential .	21	Betri eb sspannung U_{BB}
13 bis 17	Datenein- und -ausgänge	22 und 23	Adresseneingänge
18 -	Prog rammi ereinga ng	24 .	Betriebsspannung U _{CC}

Grenzwerte (auf UBE	bezogen).					
		min max				
Betriebsspannung en	U_DD	-0,5	20	V		
		\mathfrak{v}^{CC}	-0,5	15	V	
		U_{SS}	-0,5	15	V	
Betriebsspannung fü	r	UPR	-0,5	32	V	
Programmierbetrieb			•			
Eingangsspannung A	\; : 0;	U_{11}		15	V	
Eingangsspannung G	S/WE	U ₁₂		15	V	
Umgebungstemperatur		ϑœ	0	70	°C	
Lagerungstemperatur		ϑ_{stg}	-55	125	°C	
Gesamtverlustleistun		209				
ϑ₂ = 45 °C		Pv		1	,25 W	
		•				
Statische Kennwerte	(auf U _{SS} b	ezogen)				
		,	mln	typ	max	
Betriebsspannungen	·	~UBB	4,75	5,0	5,25 V	
		ncc	4,75	5,0	5,25 V	
		UDD	11,4	12,0	12,6 V	
Eingangs-HIGH-Spar für Chip-Select, Adre Daten	U _{IH1}	3,0	U _{CC}	+0,5 V		
Eingangs-HIGH-Spar						
für Programmierung	an CS/WE	U _{IH2}	11,4		12,6 V	
Eingangs-LOW-Spannung		U_IL	- 0,5		0,8 V	
Umgebungstemperat	Ur	∂ _a	. 0	25	70 °C	
Mr		Meßbedingu	•	min	max 7 μA	
Eingangsreststrom	կ	U _{IH}	= 5,5 V		7 μΑ	
		UCS/WE	= 5,5 V			
		v_{OH}	≕ 5,5 V			
Ausgangsreststrom	lo	UCS/WE	= 3,0 V		7 μA	
Ausgangsspannung Low	UOL	OL	== 1,6 mA		0,4 V	
Ausgangsspannung	UOH	UIL	== 0,8 V	2,4	V.	
High		UIH	= 3 V			
Statische Strom-	I _{BB}	−U _{BB}	₩ 5,25 V	-45	mΑ	
- aufnahme	[]	UCC	= 5,25 V		•	
	Icc X	UDD	= 12,6 V		10 mA	
	[]	UIH .	== 5,25 V		•	
•	I _{DD}	UCS/WE	≕ 5,25 V	. •	65 mA,	
	, (-	•		•	

Programmierte	l _{PR1}	Meßbed U _{IH}	dingung = 3 V	en		min		ax 20 mA
Stromaufnahme	· - • -	$U_{CS/WE}^{-11,4} V$ $U_{PR} = 26 \pm 1 V$				•		
	I _{PR2}	UPR	$= 1 \text{ V},$ $U\overline{CS}$	U _{IH} = /WR =		-3		mA
Eingangskapazität	Cl		U 3,	, ••••				6 pF
Ausgangskapazität	co				•		•	12 pF
Dynamische Kennwerte								
Zugriffszeit	*ACC	ucc		4,75 V			4:	50 n s
A ₃ A ₉		UDD	==	11,4 V				
Chip-Selektions- zeit	*co						17	2C ns
Chip-Deselektions- zeit	[†] OD			•			1:	20 ns
Programmierbedingungen			min		typ		ma	K
Betriebsspannungen		U_BB	-5,25		-0,5		-4,7	5 V
bezogen auf USS		UCC	4,75		5,0		-	25 V
Programmierimpuls H-Pegei		U _{DD} U _{PRH}	11,4 25		12,0 26		12,6 27	5 V V
Programmierimpuls L-Pegei		UPRL	0				1	٧
Betriebstemperatur (Programmierbetrieb)		ð _a ´	20		25		30	°C
Program mierimpuls- breite		₹P.	0,1				1	ms
Programmierimpuls- anstiegszeit		^t PRR	0,5				2	μ\$
Programmierimpuls- abfailzeit	-	*PRF	0,5				2	μs
Programmierzeit		⁵ N⋅tp	50					ms
Adressenbereitstelizeit		*AS	10					ms
CS/WE-Bereitstellzeit		tCSS	10					μs
Daten-Bereitstellzeit		^t DS	10				•	μs
AdressenHaltezeit 5)		t _{AH}	1					μs
CS/WE-Haltezeit 5)		tCH	0,5					μs
Daten-Haltezeit	•	tDH	1					μs
Datenverzögerung nach Programmier-/Lese- umschaltung		^t DPR	~				10	μs